



長寿命化

UIP[®]

UBE Transform Tomorrow Today

長寿命化に貢献する超耐熱ポリイミドパウダー

Long-Life Polyimide Powder UIP[®]

高耐熱・高信頼性を実現

Superior Heat Resistance and Reliability

極限環境での長寿命化により
サステナブルな社会の実現に貢献



製品ラインナップ

UIP[®] -R

バランス型

- HDT 360℃の耐熱性
- 曲げ弾性率 4.2GPa
- 耐熱性・強度・成形性のバランス
- 汎用用途に最適

主な用途 摺動部品、シール材、
半導体製造装置部品 など



UIP[®] -S

超耐熱型

- HDT 500℃の超耐熱性
- 曲げ弾性率 8.0GPa
- 高剛性・低クリープ
- 高温環境下で信頼性向上

主な用途 高温機械部品、絶縁部材、
高温環境下の各種部品 など

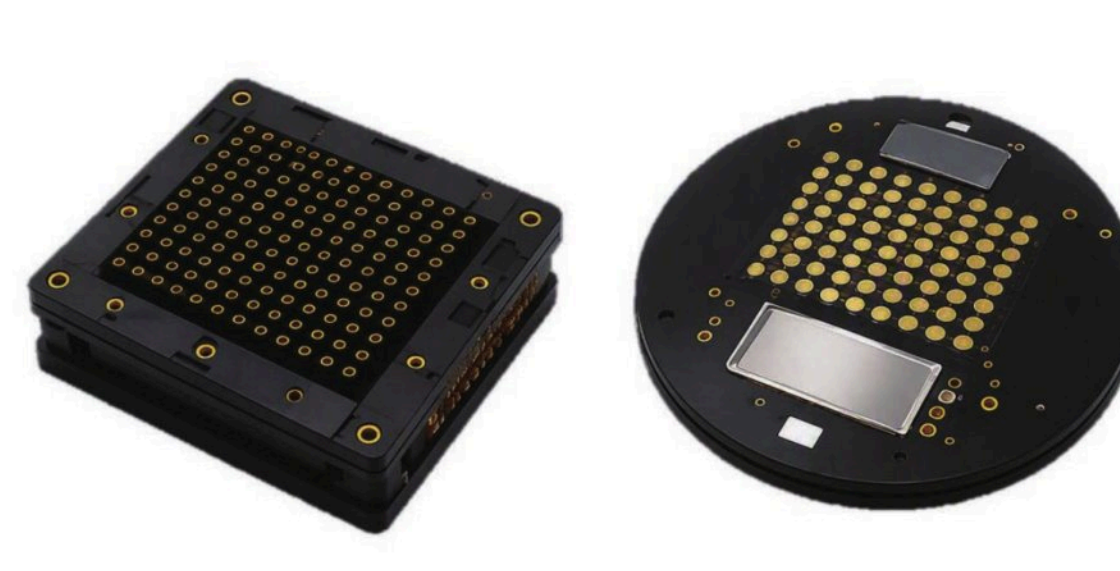


UIP[®] -SA

高精度加工型

- HDT 470℃の超耐熱性
- 曲げ弾性率 7.5GPa
- 低CTE・低吸水性
- 高剛性・高寸法安定性
- 微細加工性に優れる

主な用途 テストソケット、プローブカード、
ウエハガイド、精密加工部品 など



26P001 (開発品)

次世代高性能パウダー

- UIP-Sを超える耐熱性
- 有機溶剤等の揮発成分なし
- 3μm以下など小粒径化が可能
- 高耐熱樹脂フィラーとして最適
- 次世代複合材料向け

主な用途 高耐熱樹脂コンパウンド、接着剤、
半導体関連材料、電子材料 など



粉体特性 (代表値)

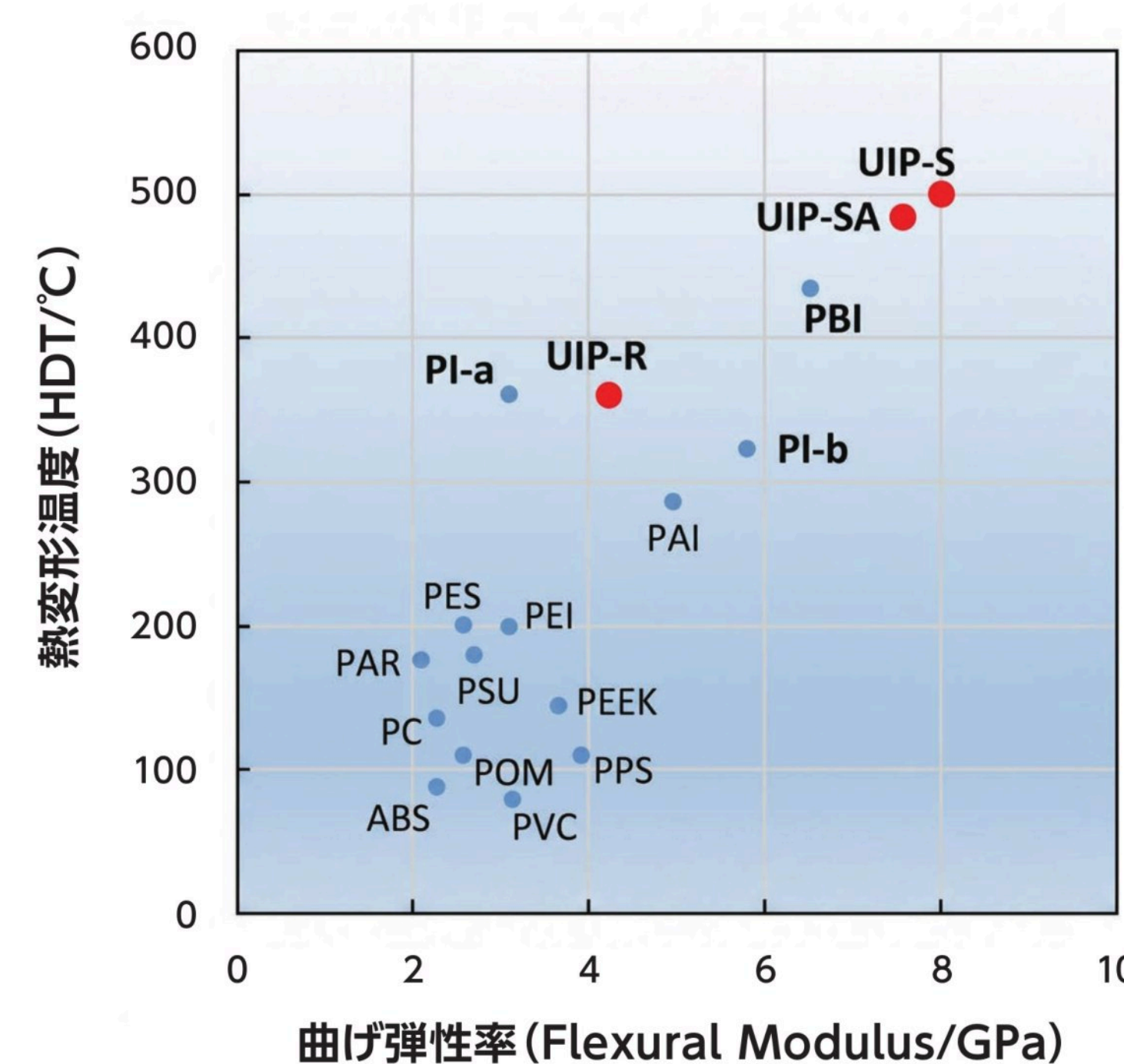
特性 Properties	単位 Unit	UIP [®] -R	UIP [®] -S	UIP [®] -SA	26P001 (Development)
平均粒径 Averaged particle diameter	μm	7	8	19	9
安息角 Angle of repose	deg	44	52	46	55
かさ密度 Compressibility	g/cc	0.32	0.30	0.35	0.22
5%重量減少温度 Temperature of 5% weight loss	℃	583	600	600	607
水分揮発分量 [50-350℃] Moisture & volatile mater contents	%	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 0.1
SEM像 SEM image	-				

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。

各種プラスチックとの成形体物性の比較

優れた耐熱性と剛性のバランス

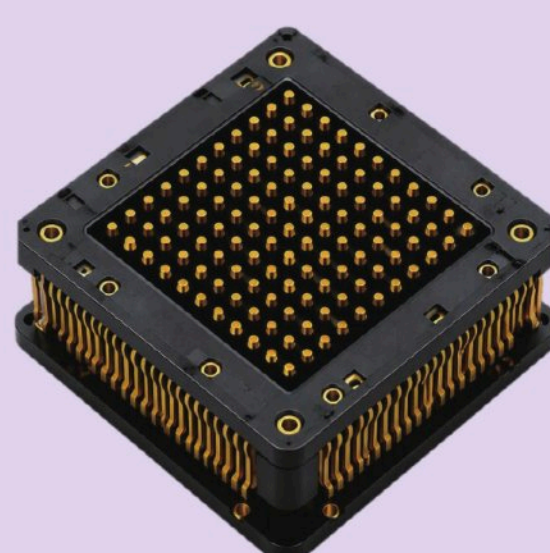
- ✓ 高寸法安定性
- ✓ 低吸水性
- ✓ 低線膨張係数
- ✓ 微細加工対応



UIP-SおよびUIP-SAは、他社PIを上回る耐熱性と剛性を両立し、
半導体検査工程など高精度要求用途に最適です。

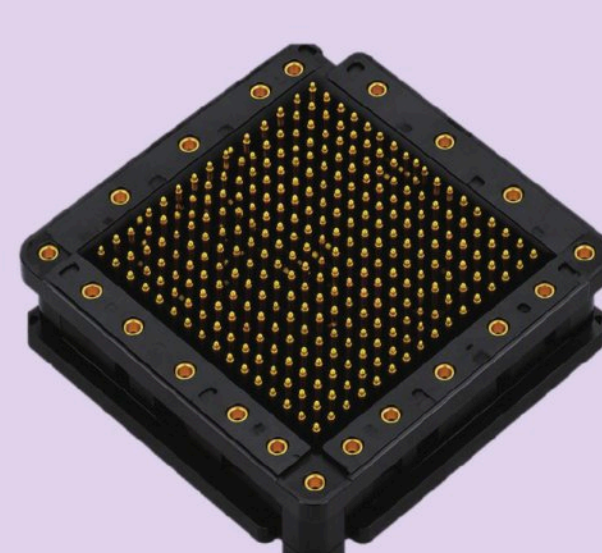
用途例

テストソケット



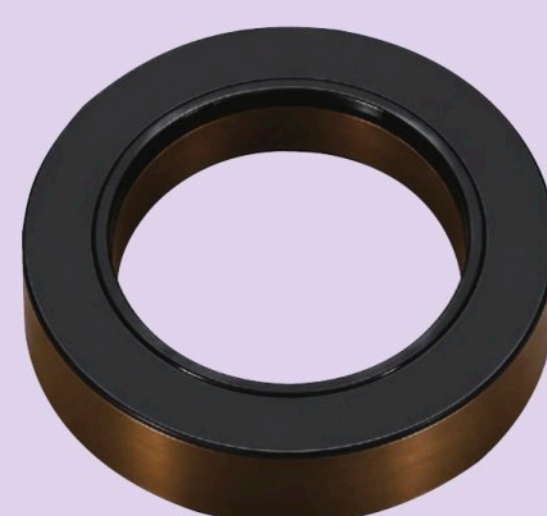
高温検査工程向けの
高信頼性ソリューション

プローブカード



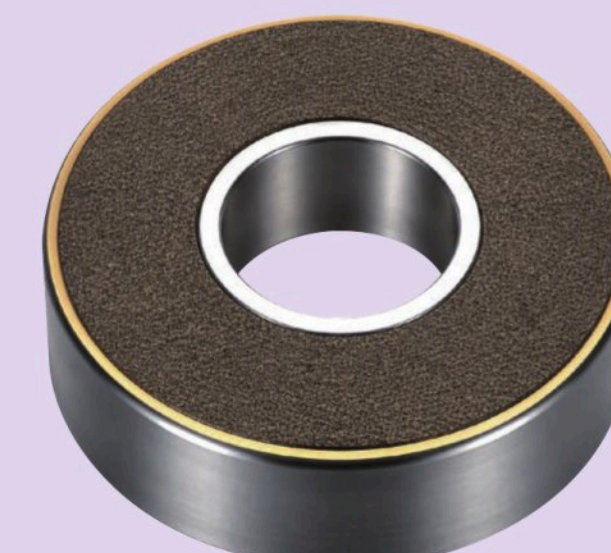
高精度検査工程向けの
高信頼性部材

ウエハガイド



高寸法安定性を
活かしたウエハ搬送部品

ダイヤモンド砥石



高耐熱バインダーで
研削性能と寿命を向上

ゴム・接着剤などへの 添加材



耐熱性・耐摩耗性向上、
機械強度向上に貢献